

SMT Systems



Semiconductor  
Manufacturing Systems



Industrial Robots

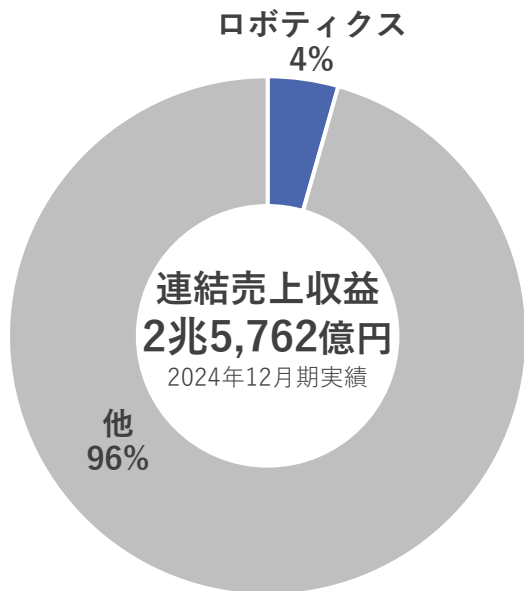


ロボティクス事業 新中期経営計画 2025-2027年

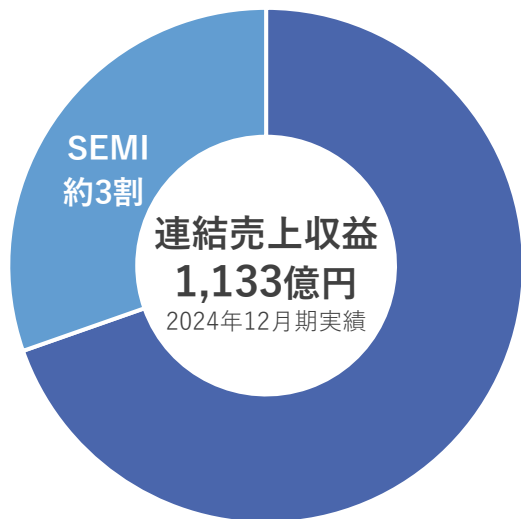
2025年3月13日

ヤマハ発動機株式会社 (証券コード: 7272)

全社



ロボティクス事業



## 主な製品

### SMTソリューション



表面実装機  
印刷機  
ディスペンサー  
検査機  
システム&ソフトウェア

### 産業用ロボット (FA)



リニアコンベアモジュール  
スカラロボット  
直交/単軸ロボット

### UMS\*



産業無人航空機

### 半導体後工程装置 (SEMI)

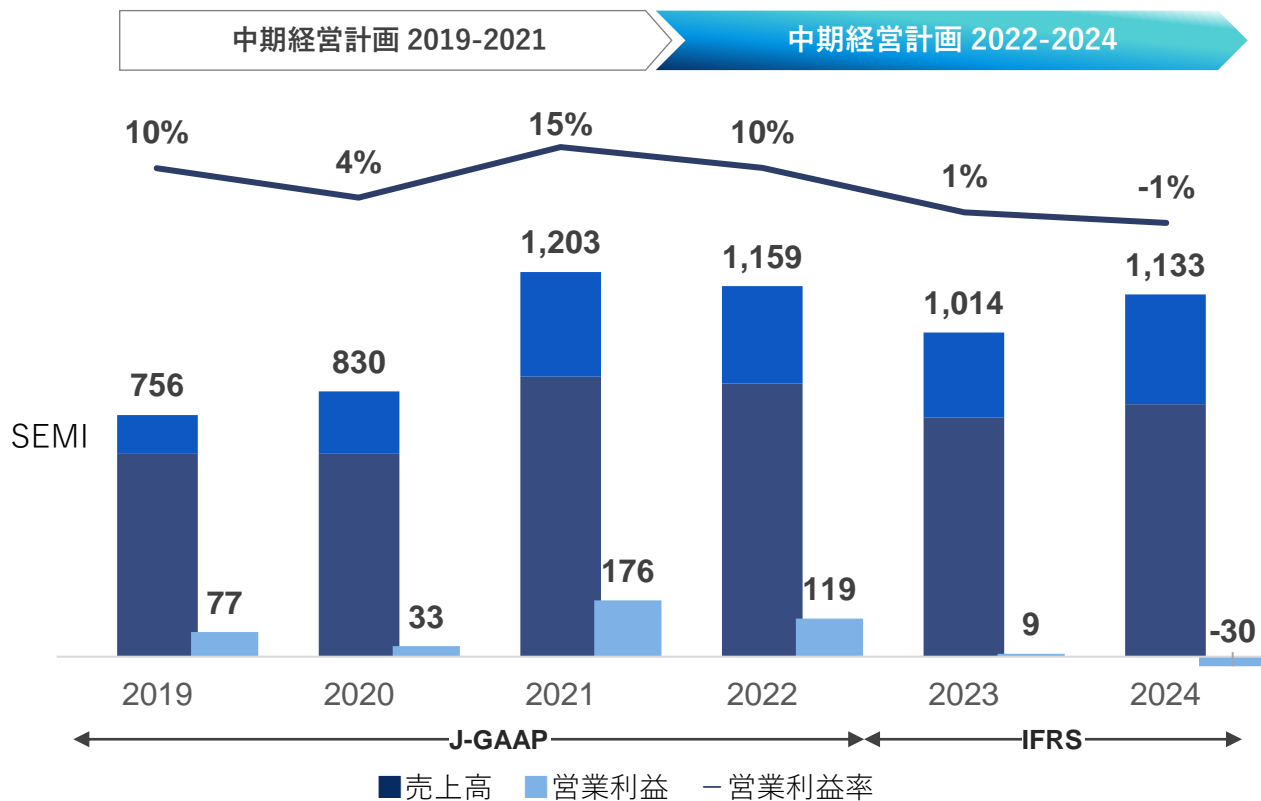


ボンディング装置  
モルディング装置  
各種自動化装置

\* Unmanned Systems

# 前中期経営計画の振り返り

## ■ 業績推移と前中期経営計画KPI



### 前中期経営計画KPI

売上高CAGR  
2021-2024 16%

YRH利益寄与率  
(2021 10%) 25%

### 2024実績

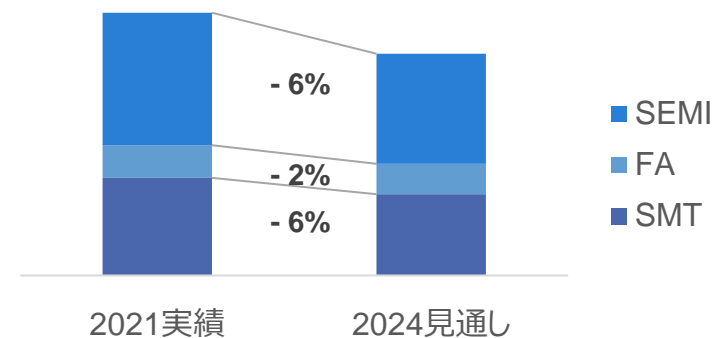
-2%

○

## ■ 総括

- ・長期成長トレンドを想定も、設備投資停滞で需要急減速。2023年を底に緩やかに回復傾向。
- ・当社は部品在庫ロス、原価高騰、厳しい市場環境下でのリソース投入継続等により収益性が悪化。

総需要 2021→2024 CAGR (当社推定)



成果	課題
<ul style="list-style-type: none"> <li>・生産能力強化 (工場増築)</li> <li>・プラットフォームモデル上市完了</li> <li>・シンガポール新会社設立</li> <li>・生成AI関連の需要取り込み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収益性改善</li> <li>・大手顧客獲得による拡販</li> <li>・エリアミックス偏重解消</li> <li>・SEMI先端技術開発</li> </ul>

# 中期戦略骨子

## ■ 機会とリスク

### 機会

- ・ 技術革新と需要の増加により市場は成長見込み
- ・ 生成AIの拡大により半導体部品需要回復傾向
- ・ 半導体関連市場の拡大/地域変化
- ・ 新規顧客獲得、先端技術開発によるシェア拡大

### リスク

- ・ 経済安保・地政学リスク
- ・ SMT/SEMI/FA領域の価格競争激化
- ・ SEMI領域の新技术開発競争

## ■ 戦略骨子

多彩な製品群の組み合わせで、グローバルに広がる  
お客様の生産工程自動化を支援し、**成長と収益性の両立**を実現

### 表面実装機(SMT)

2024→2027 売上収益CAGR **15%**

車載大手 + EMS開拓を軸に  
業界Top3への挑戦

### 半導体後工程(SEMI)

2024→2027 売上収益CAGR **18%**

技術進化を先取りし  
市場ポジションを塗り替える

### ファクトリーオートメーション(FA)

2024→2027 売上収益CAGR **14%**

SMT・SEMIと連携した  
自動化ソリューション実現

### 事業KPI

#### 事業成長

CAGR 15%水準

#### ROS

17%水準

※本社コーポレート経費配賦前

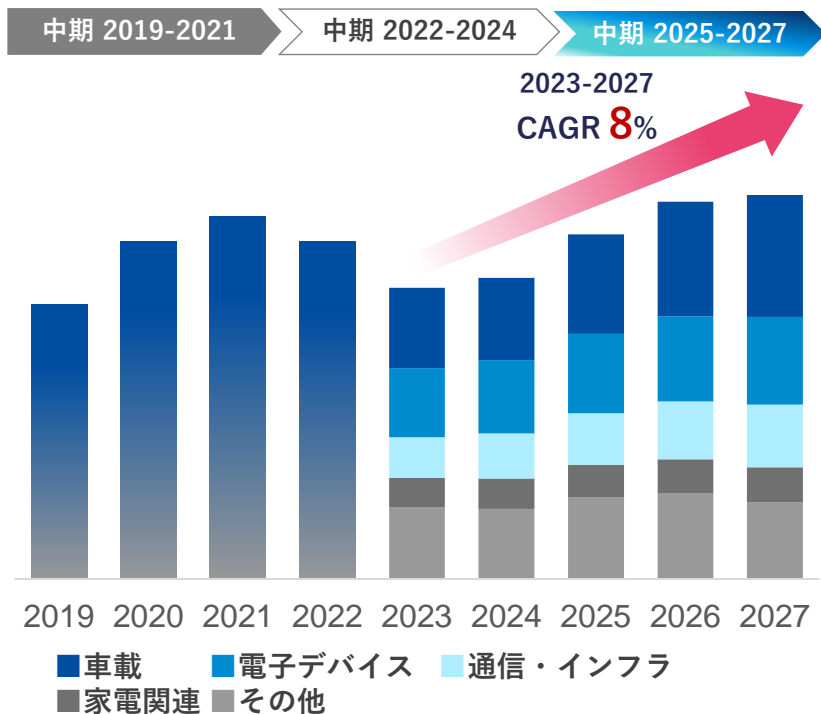
#### ROIC

15%水準

※本社コーポレート経費配賦前

## ■ SMTセグメントの需要動向

2027年 約5,000億円規模の市場へ



※出展：富士経済の資料をもとに当社推計

## ■ 戦略

### ● 車載大手・大手EMS顧客獲得 ▶ 売上構成比 +10%以上 (2024→2027)

- ・ クロスセル営業×エリア営業連携強化
- ・ 対象部品のカバレッジ拡大による、車載部品・サーバー関連投資の取り込み

### ● 収益性の向上

- ・ 主力モデルを中心としたコスト改革
- ・ 業務システム刷新/自動化/効率化による調達・組立リードタイム短縮

### ● グローバルに展開するお客様への提案・サポート力を強化

- ・ アメリカ・東南アジア・インド市場の販売・サービス体制の強化

## ■ 当社が狙う領域

### ● 車載部品関連



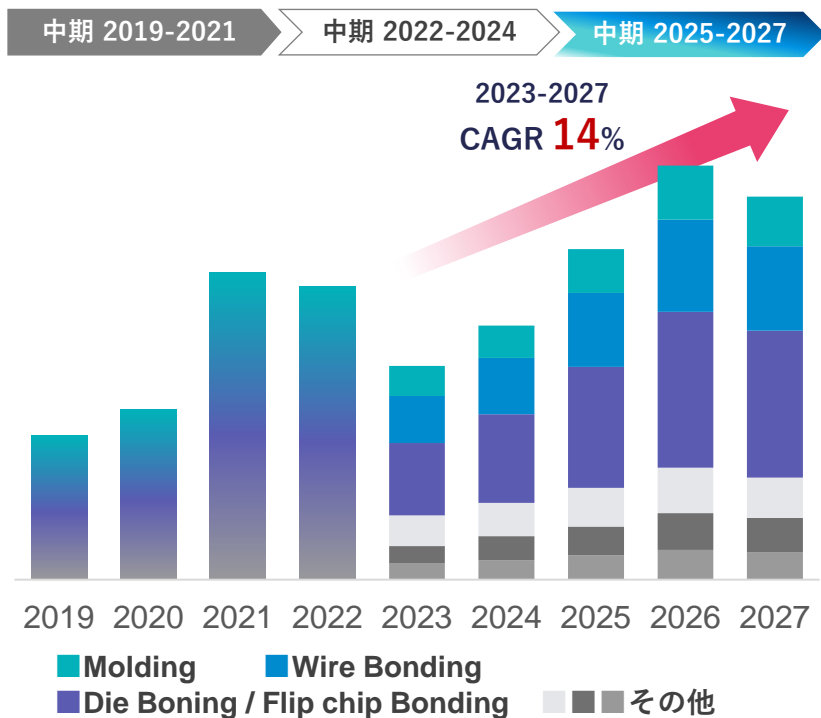
### ● 通信デバイス関連



### ● ネットワーク関連



## ■ SEMIセグメントの需要動向



※出展：TechInsights の資料をもとに当社推計

## ■ 戦略

### ● コア領域で稼ぎ、先端半導体領域で伸ばす ▶ 2027年時点 売上高200億円増

- コア領域への新プラットフォームモデル投入
- 先端半導体領域への新プロセス技術の投入
- 生産能力の増強
- 事業構造改革を推進する組織体制への変更

## ■ 当社が狙う領域

### ● 先端半導体(AI)



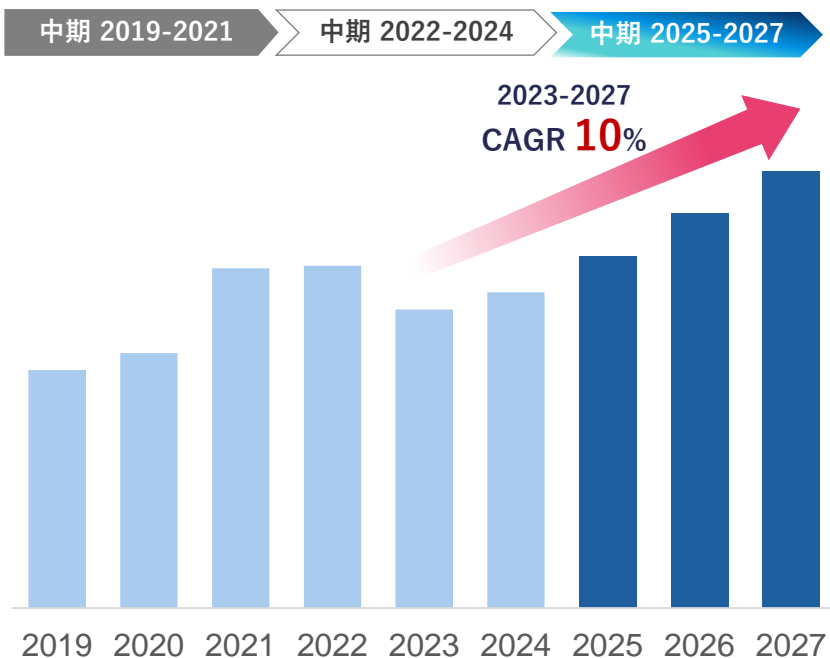
### ● パワー半導体



### ● メインストリーム半導体



## ■ FAセグメントの需要動向



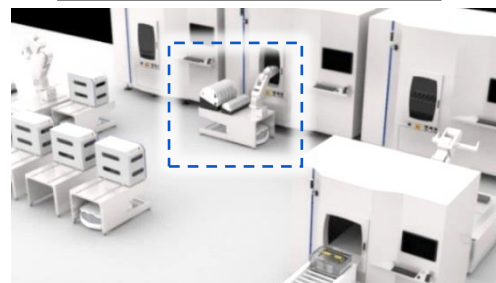
※出展：富士経済及びQY Researchの資料をもとに当社推計

## ■ 戦略

### ● ビジネスモデル再構築し成長軌道へ

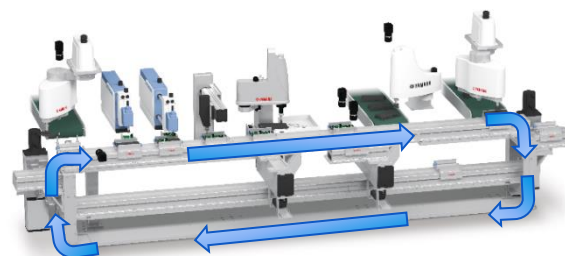
- SMTやSEMIと連携したソリューションビジネスの確立
- リニアコンベアを中心にしたシームレスな統合環境と効率的なシステムを提供
- アカウント営業の強化

#### SMTラインとの連携例



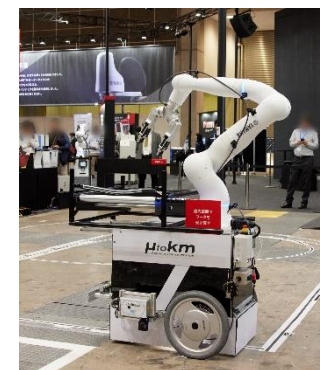
ストレージからの搬送

#### 搬送系アプリケーション例



循環ユニット提案

#### 協働ロボットとの連携例



協働ロボットとAGVの連携

- 開発・投資方針：注力領域を明確にし、リソースを集中投入する

